

Mate 2008 第14回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」 シンポジウム参加者募集

主催：(社)溶接学会 マイクロ接合研究委員会
共催：(社)機械学会 エレクトロニクス実装における信頼性設計と熱制御に関する研究分科会，(社)高温学会 微細加工研究情報委員会，(社)日本塑性加工学会 接合・複合分科会，(社)日本電気制御機器工業会，エレクトロニクス生産科学学会準備会，レーザ加工学会，大阪大学 先端科学イノベーションセンター

協賛：映像情報メディア学会，エレクトロニクス実装学会，応用物理学会，化学工学会，画像電子学会，軽金属学会，計測自動制御会，高温学会，高分子学会，資源・素材学会，システム制御情報学会，情報処理学会，精密工学会，電気化学会，電気学会，電気設備学会，電子情報通信学会，日本機械学会，日本金属学会，日本顕微鏡学会，日本材料学会，日本シミュレーション学会，日本接着学会，日本セラミックス協会，日本塑性加工学会，日本電気制御機器工業会，日本伝熱学会，日本非破壊検査協会，日本表面科学学会，日本品質管理学会，日本複合材料学会，日本物理学会，日本分析化学会，日本溶接協会，表面技術協会，プラスチック成形加工学会

開催趣旨

日本のエレクトロニクス産業は、この20年間、高機能化、高信頼化、小型化、低コスト化の技術開発に支えられた新たな電子デバイス・部品を組み込んだ電子システム創成の下、日本の高度成長を牽引してきました。今後も日本が世界を先導し続けるには、生産技術を科学的に探求することはもちろんのこと、既存の学問領域、設計・生産技術などの領域を越えて、エレクトロニクスを取巻く科学技術、経営・生産システム、価値システム、などの広い範囲を取り込んだグローバルなオプティマイゼーションとそれに基づくシステムインテグレーションが不可欠になってきています。本シンポジウムでは、これら生産技術に関する最新の研究・開発に関する研究者相互の情報交換の場をより広くかつ定期的に持ち、生産の科学と技術の進展を促すことを目的として企画開催されます。

日時：平成20年2月5日(火) 8:50～17:50
平成20年2月6日(水) 9:00～17:30

会場：パシフィコ横浜 会議センター
5階(小ホール、501, 502, 414, 415)
横浜市西区みなとみらい1丁目1-1
TEL: 045-221-2121

シンポジウム参加登録費(論文集代を含む)

- 主催・共催団体登録会社 : 20,000円
- 協賛学協会会員会社 : 30,000円
- 論文口頭発表者 : 15,000円
- 大学、国公立研究機関 : 10,000円
- 学生 : 5,000円
- その他(一般) : 40,000円

シンポジウム参加申込方法

下記シンポジウムURLより平成20年1月25日(金)までに参加登録を行って下さい。

<http://wwwsoc.nii.ac.jp/jws/research/micro/mate/Mate2008.html>

参加受付証はプリントアウトの上、当日ご持参下さい。参加費のお支払いは、銀行振込・現金書留のいずれかでお願ひ致します。

問合せ、申込先：Mate 2008 事務局 事務代行
合同会社フロンティア・アライアンス
ものづくりリエゾンオフィス内
TEL: 06-6878-5628, FAX: 06-6879-7568
E-Mail: mate@fa-mlo.com

参加申込締切日：平成20年1月25日(金)

振込先銀行：三井住友銀行 千里中央支店
口座番号：普通No.0837623
口座名義：Mate 受付事務局

シンポジウム URL

<http://wwwsoc.nii.ac.jp/jws/research/micro/mate/Mate2008.html>

プログラム(セッション名と発表件数)

2月5日(火) 8:50～17:50 (18:00～懇親会)

◆プレナリーセッション

「日本のものづくりの国際競争力」(仮題)
(東京大学ものづくり経営研究センター 小川絏一)

「超精密限界への挑戦」

(株)ニコン 精機カンパニー開発本部 馬立和利)

「車載モジュールの差別化戦略」

(株)デンソー EHV機器事業部 水野哲哉)

「デジタル素材分野」

(依頼中)

2月5日(火) 8:50～17:50

- [A-1] むれ・溶食(4件)
- [A-2] 界面反応・解析技術I(4件)
- [A-3] 界面反応・解析技術II(4件)
- [B-1] ナノ粒子接合(4件)
- [B-2] パンプ実装(5件)
- [B-3] パンプ実装/信頼性(5件)
- [C-2] 固相接合(5件)
- [C-3] 薄膜(5件)

2月6日(水) 9:00～17:30

- [A-4] 鉛フリー(4件)
- [A-5] ソルダリング材料(5件)
- [A-6] 熱疲労信頼性(5件)
- [A-7] 評価・信頼性(4件)
- [B-4] 基板・樹脂(4件)
- [B-5] MEMS・微細加工(5件)
- [B-6] レーザ微細加工(5件)
- [B-7] パッケージ開発(4件)
- [C-4] 開発(5件)
- [C-5] 開発・設計(4件)
- [C-6] 樹脂材料(5件)
- [C-7] 検査・評価技術(4件)

(一般論文発表合計90件)



Best Author 賞(JWS Best Author Award)の推薦について

下記により Best Author 賞の推薦を募集いたします。

本年第1号(1月号)から第8号(12月号)までに会誌に掲載された記事の中から優秀と認められるものを、巻号、題名、著者、推薦理由を記して、1編、編集委員会宛て推薦下さい。

【賞の概要】

会誌「溶接学会誌」に発表された記事のうち、特に多数の会員の研鑽、及び、学術、技術の向上、普及に貢献した記事の著者に授与される。

【選考委員】

同賞選定委員会

委員長：会誌編集委員長

委員：編集委員より数名(各分野代表+総合企画+副委

員長)

【選考方法】

会誌編集委員および会員モニタの推薦による記事の中から選定委員会で選定する。

【選考基準】

溶接学会誌の本年第1号(1月号)から第8号(12月号)までに掲載された記事の中から、優秀と認められるものを、原則として毎年数編以内選定する。

【表彰等】

4月通常総会席上で表彰、賞状の贈呈。

【推薦書送付先】

(社)溶接学会 編集委員会宛

大阪大学大学院工学研究科マテリアル生産科学専攻助教公募

1. 公募人員：助教 1名
2. 所 属：生産科学コース 生産プロセス講座 複合化プロセス工学領域
3. 専門分野：溶接・接合における材料科学の探究及びその体系化を行うと同時に、周辺プロセス技術との融合化、プロセスの合目的化などを包括した知的接合プロセス工学への展開を目指した教育と研究を行う。
4. 担当講義：複合化プロセス工学及び生産科学実験、創成科目（生産創成工学）、情報処理演習、生産科学創成工学などの演習科目
5. 応募資格：
 - 1) 上記専門分野に関する研究能力があり、溶接・接合プロセスにおける材料挙動を実験的および理論的に解析できる方
 - 2) 博士の学位を有する方
6. 着任時期：決定後できるだけ早く
7. 任 期：5年（再任可）
8. 応募書類：
 - 1) 履歴書：任意書式、A4用紙、写真貼付（現住所、連絡先（電話番号、電子メールを含む）、学歴（高校卒業以降）、職歴、研究歴、所属学会、資格、学位、賞罰）
 - 2) 業績リスト（査読付原著論文、国際会議論文、解説、著書、特許に分類）
 - 3) 主要論文の別刷またはコピー（3編程度）、各3部
 - 4) 受賞があれば、その名称、受賞対象（論文名等）と受賞年
 - 5) 今後行おうとする教育・研究に対する抱負（A4用紙2000字程度）
9. 書類送付先：

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-1
大阪大学大学院工学研究科マテリアル生産科学専攻長
教授 西本和俊

封筒の表には「複合化プロセス工学領域応募書類」と朱書し、簡易書留にて郵送して下さい。提出書類は返却致しませんので御了承下さい。
10. 応募期限：平成20年1月18日（金）
11. 選考方法：

書類審査の後、必要に応じて面接、セミナーをお願いすることがあります。なお、適任の候補者が得られない場合には、最終候補者を選考しない場合があります。
12. 問合せ先：

マテリアル生産科学専攻生産科学コース
教授 西本和俊
Tel:06-6879-7541
E-mail:nisimoto@mapse.eng.osaka-u.ac.jp